

HC低压注塑热熔胶粒

产品名称	HC低压注塑热熔胶粒
公司名称	上海弘翀新材料科技有限公司
价格	88.00/公斤
规格参数	品牌:HC 型号:1809 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区望园南路2288弄1号412室（注册地址）
联系电话	18516395699 18516395699

产品详情

HC低压注塑热熔胶粒

我们针对低压注塑行业 开发了 低注塑温度低压注塑热熔胶 针对ABS
TPU有优异粘接力的低压注塑热熔胶

高强度耐高温低压注塑热熔胶 高柔韧性低压注塑热熔胶 超高硬度低压注塑热熔胶

汽车连接器用低压注塑热熔胶

手机电池壳低压注塑热熔胶

PCB线路板封装低压注塑热熔胶

线束微动开关低压注塑热熔胶

注塑成型工艺是指将熔融的低压注塑材料原料通过加压、注入、冷却、脱离等操作制作一定形状的半成品件的工艺过程。

低压注塑工艺则是一种使用很低的注塑压力（0.15-4MPa）将热熔的低压注塑材料注入模具并快速固化的封装工艺，以热熔低压注塑材料卓越的密封性和物理、化学性能来达到绝缘、耐高温、抗冲击、减振、防潮、防水、防尘、耐化学腐蚀等功效，对电子元件起良好的保护作用。

Polyamide (PA) 聚酰胺热熔胶 “ Polymelt ”

用于电子成型的封装材料是基于自然脂肪酸、二聚酸的热塑性热熔胶粘剂。天然无毒无公害，可生物分解，可回收利用。

这些天然原材料保持了宽广的工作温度范围(-50 / 170)，符合UL标准及RoHS/REACH环保规范。

无溶剂、单组份固态

较低的吸水率 (<1.0%) 及较好耐水性能 (IP 6X)

良好的电气绝缘性 (介电强度>25kV/mm)

低熔点、低黏度、低注射压力

耐高低温 (-50 / 170)

低压注塑工艺特点：

- 1、更低压力，低至1.5bar的注塑压力，确保电子元件不被应力损坏，极大程度地降低了废品率；
- 2、更低温度，注塑温度低至150摄氏度，即便是PCB软板也可轻松包裹，保护脆弱的电子元器件，避免了不必要的浪费。
- 3、更快成型，低压热熔胶注塑成型的工艺周期可以缩减低至5秒，极大的促进了生产效率。
- 4、更高效率，选择低压注塑成型工艺不但可以大幅度提高生产效率，还可以降低产成品的次品率，从总体上帮助生产企业建立成本优势。
- 5、模具简单，低压成型模具可采用铸铝模，而不是钢材，所以非常易于模具的设计、开发和加工制造，可大大缩短开发周期。

低压注胶成型工艺：

注胶压力低(1.5-40Bar)；

注胶温度低(180-240)；

模具可采用多种材料；

理想的敏感、精密元件器的生产工艺；

注胶机采用气压驱动，对环境无污染；

胶料和产品粘接性好，防水密封性能高；

如所示，针对高压注塑的缺陷，低压注塑胶料熔融后粘度低，高流动性的低压注塑热熔胶系列产品，聚酰胺热熔胶在融化后只需要很小的压力就可以使其流淌到很小的模具空间中，因而不会损坏需要封装的脆弱元器件，极大程度地降低了废品率。